

证券代码：002845

证券简称：同兴达

# 深圳同兴达科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-0425

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	以网络方式参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年04月25日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 万锋先生 董事、副总经理、财务总监 李玉元女士 投资总监 姚拥军先生 独立董事 卢绍锋先生 董事会秘书 李岑女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2024年4月25日（星期四）15:00-17:00以网络文字交流的方式召开了2023年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流，问答情况如下：  1. 2023年归母净利润同比增长219%的主要原因请公司说一下？

答:您好, 公司2023年归母净利润同比增长主要是公司主要产品毛利率及出货量双提升, 及苦练内功持续优化内部管理、降本增效效果显著等影响。

**2. 昆山工厂预计什么时候建成? 投产后能带来多少产能?**

答:您好, 公司昆山显示驱动芯片封测项目(一期)将建成月产能2万片12寸全流程GoldBump(金凸块)生产工厂, 预计于2025年建成完毕, 谢谢!

**3. 请问一季度扣非归母净利润为负是什么原因?**

答:您好! 公司一季度扣非归母净利润详见公司一季度的业绩预告。业绩预告为盈利。

**4. 公司哪些产品业务属于低空经济领域?**

答:感谢您的关注。公司的摄像头模组涉及低空经济领域。

**5. 请问, 昆山日月同芯什么时候完成一期投资, 目前进展情况? 量产爬坡情况? 什么时候产生利润?**

答:您好, 昆山日月同芯项目正处于产能爬坡关键时期, 进展顺利, 行业知名大客户也在积极导入中, 整个项目按计划推进, 谢谢!

**6. 2024年的经营目标是什么?**

答:您好, 请持续关注公司的相关公告。

**7. 贵公司目前披露ESG报告, 未来有什么具体的方案去提升ESG评分和公司治理水平吗?**

答:您好, 提升ESG评分和公司治理水平是个系统工程, 涉及到公司战略规划、内部管理及外部沟通等多个方面, 具体的方案与措施包括但不限于明确责任与权责边界、优化决策程序、强化董事会运作、优化股东大会职能、强化监事会职能、强化ESG信息披露质量, 开展内外部ESG沟通等, 通过上述措施提升公司整体治理水平,

谢谢!

8. 请问公司是华为，荣耀，传音公司供应商，这三个手机一季度出货量大幅度增长，是否带动公司盈利增长?

答:您好，我司一季度扣非归母净利润同比大幅提升，详见公司一季度业绩预告，谢谢

9. 公司有没有回购、股权激励计划?

答:感谢您的关注。关于公司是否存在回购、股权激励计划，请关注公司后续公告。

10. 公司每年研发支出很大，是否在chiplet技术有储备?

答:您好，公司半导体先进封测团队目前聚焦于显示驱动芯片封测技术，同时加强其他先进技术的研发储备，包括但不限于chiplet、cowos封测技术等，谢谢!

11. 公司今年是否会考虑提高分红比例?

答:感谢您的关注。公司2023年利润分配预案已经公告，请详见公司公告。

12. 公司跟华为深度合作，是否战略考虑将昆山日月同芯项目跟华为海思战略合作?

答:您好，与战略客户实现战略合作，为国家先进半导体行业贡献绵薄之力，是公司荣幸与目标，谢谢!

13. 尊敬的万总，公司今年所处的行业复苏，公司二季度，三季度订单怎么样? 公司负债比较高? 怎么减少资本开支?

答:您好，如您所言，行业目前处于复苏阶段，且因供给侧变化带来的影响，预计公司二季度、三季度订单同比去年同期大幅提升。集团目前整体资产负债率处于安全可控范围，原有主业资本开支已结束，目前主要拓展先进封测第二增长曲线，整体现金流健康，谢谢!

	<p><b>14. 公司昆山日月同芯封测项目投产后，国内技术，规模处于什么地位？</b></p> <p>答:您好，集团控股子公司昆山日月同芯半导体有限公司设立于2021年12月6日，注册资本9.90亿元，项目一期将建成月产能2万片12寸全流程 GoldBump（金凸块）生产工厂，目前正在推进过程中，生产规模在中国大陆处于领先地位，谢谢！</p> <p><b>15. 请问公司昆山半导体项目一期几条产线？正在产能爬坡的有几条产线？目前光学模组产品毛利预计何时能回到正常水平，并实时赢利？</b></p> <p>答:您好，项目一期将建成月产能2万片12寸全流程 GoldBump（金凸块）生产工厂，目前正处爬坡关键阶段，行业知名大客户正在顺利导入中；光学模组产品表现预计今年将取得积极反馈，谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年04月25日